

2023年9月15日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社  
(コード：6721 東証スタンダード市場)  
代表者名：代表取締役 姜 輝  
問合せ先：専務取締役 樋口 真康  
(TEL：045-317-7888)

### 第三者割当による新規株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、楽言海外国際(香港)有限公司(以下、「楽言」、又は「割当予定先」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による新規株式(以下、「本新株式」といいます。)の発行を行うこと(以下、「本第三者割当」といいます。)を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 募集の概要

<本新株式の募集の概要>

(1) 払込期間	2023年10月2日～2023年11月30日
(2) 発行新株式数	3,669,000株
(3) 発行価額	1株につき109円
(4) 調達資金の額	399,921,000円 発行諸費用の概算額を差し引いた手取り概算額については、「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(1) 調達する資金の額」をご参照下さい。
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 楽言海外国際(香港)有限公司 3,669,000株
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。

(注) 本第三者割当増資に関しては、2023年10月2日から2023年11月30日までを会社法上の払込期間として決議しております。この期間を払込期間とした理由は、割当予定先が外国企業であるため、送金に時間がかかることが予想されますので、届出書の提出時点においては当該時期が確定できないためです。

#### 2. 募集の目的及び理由

##### (1) 資金調達の経緯

##### ① 当社グループの事業概要

当社は、半導体自動検査装置のメーカーとして今年で31期目を迎える、半導体の検査を中心とした会社です。当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、スマホやPC等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバーIC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足下では、2022年8月から顕在化した民生向け半導体(特にスマホやPCなどの情報端末系)の在庫調整も2023年上半年中には一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかるとされています。そのため、2023年6月末時点においてもまだ、スマートフォンやPCな

どの情報端末関連機器における需要低迷が響き、それらで使用される半導体を中心にだぶつき感が否めない状況が続いております。顧客各工場は、生産調整に入っており当社もその影響を受け第2四半期中の受注は低迷致しました。

上記のように、依然として半導体市場の足踏み状態は、続いておりますが、半導体分野は、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。また2022年6月に続き2023年6月に経済産業省の肝いりで発表された日本半導体復活の号令に伴い、台湾 TSMC の熊本進出、そして日本半導体有力各社による新会社ラピダスに代表されるように日本中が半導体復活に向け、動き始めています。その結果、半導体関連では、人材不足が深刻に叫ばれることとなり、次世代検査装置の開発にも遅れが発生、特に当社のような中小規模企業においては、成長が妨げられる一つの要因となっております。

上記の結果、2023年12月期第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は186,416千円（前年同四半期比69.8%増）、営業損失249,453千円（前年同四半期は営業損失349,286千円）、経常損失239,355千円（前年同四半期は経常損失323,882千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失240,594千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失325,120千円）となりました。

また2023年12月期第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローも営業活動の結果減少した資金は306,840千円（前年同四半期は、245,372千円の減少）となりました。これは主に、売上債権の増加額44,385千円、仕入債務の減少額23,357千円及び税金等調整前四半期純損失239,355千円等による資金の減少があったことによるものです。さらに当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて45,991千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には232,488千円となりました。

上記のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

## ②事業施策(営業戦略、マーケット戦略)

2022年8月から顕在化していた民生向け半導体の在庫調整も2023年上半期中には一段落するものと予測されておりましたが、回復にはまだ時間がかかる状況であり、半導体チップ、特に民生機器の一部である、スマートフォンやPC、そしてIT情報端末機器などの半導体製品にだぶつき感が発生し、各半導体工場における在庫抑制を目的とした生産調整が発生しました。そのためスマートフォンやPC向けパネルそしてパネルを駆動するLCDドライバーチップ等の在庫増が嫌気され、デザインハウス（注1）及び大手OSAT（注2）を中心に工場の稼働率は回復の兆しはあるものの、現時点では7割から8割程度であり、市場は新規設備投資に慎重な姿勢を崩しておりません。しかし、2024年を含む中期的には、自動車の電動化、再生エネルギー関連及び5Gへの投資需要が強く見込まれており、また、急速に需要が高まっている生成人工知能（AI）も半導体チップの需要を押し上げる要因となっていることから、市場は力強く成長すると見られております（Electronic Engineering Timesより、以下「EETIMES」という。）。

（注1：半導体集積回路の設計や開発を行う専門会社、メーカーにあたる）

（注2：製造された半導体集積回路の検査やICパッケージへの組立を行う専門会社）

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上（例、線幅4nmから2nm）は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性

も要求されるため、半導体検査市場は、装置能力の向上に加えて装置台数の増加が期待される方向と考えられております。

当社グループが「主力装置」と位置付ける LCD ドライバ IC 検査装置は、スマートフォンや PC 等の情報端末の液晶パネルの駆動に使われる「ディスプレイドライバー IC」の検査に使用されております。また、それら情報端末には、「CMOS イメージセンサー IC」、「ロジック IC」など多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足元では、上記のように半導体市場の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

上述のような理由から当第 2 四半期連結累計期間中では、受注は低迷致しましたが、当社の主力検査装置「WTS-577SR」につきましては、2021 年から販売を開始し、当第 2 四半期連結累計期間において、進化する新デバイスに向けた装置の貸出しを伴うベンチマークを積極的に進め、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができましたが、上述 のような市況状況もあり、受注には至っておりません。

2023 年の半導体市場は、世界半導体市場統計(WSTS)や日本貿易振興機構(JETRO)等の予想では、民生向け半導体(スマートフォン、PC 向け半導体等)を中心として、依然として生産調整が 2023 年後半まで続くとの見方があります。他方、半導体製造装置セクターにおいては、2023 年前半は落ち込むが後半から 2024 年にかけて徐々に回復との予測もあり、当社においては、当期 8 月以降における半導体検査装置の受注は 2023 年 2 月 14 日に公表している通期予想に組込んでおります。

新戦略として、2023 年 3 月 6 日に PR で開示いたしました、「株式会社 RS Technologies と販売店契約締結のお知らせ」のとおり、新たに日本における大手再生シリコンウエーハ製造会社である株式会社 RS テクノロジーズ(東京都品川区、代表取締役 方 永義)を販売店に迎え、国内外の受注拡大を狙い、現在準備を進めております。

また、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術(武漢)有限公司」(以下、「ウインテスト武漢」という。)の営業体制の拡大強化を行い、特に中国、台湾においての直接受注を目指します。また、海外営業と海外アフターサポート体制の拡充を進め、営業活動の再構築を図ってまいります。

次に、ウインテスト武漢においては、顧客対応力の強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

さらに中国市場攻略のスピードアップを進めるため、ウインテスト武漢において、大手優良デザインハウス数社に的を絞った戦略を取り、関連する OSAT への貸出しを進め、営業・納入・サポートと一貫体制を敷き、顧客からの信頼獲得を図ってまいります。

### ③技術開発の強化戦略

先端ロジック IC 検査装置(1024 チャンネル、820Mbps)に関しては、第 1 四半期に前倒しで一部機能のリリースを行い、引続き次世代向け機能としてロジックパターンスピードが 1,600Mbps となる高速リソースの開発を継続しており、当第 4 四半期中には開発を終了し、お客様への提供を開始する予定です。更に 2024 年の完成を目指す、次世代検査装置開発のバージョン 2 となる「WTS-9000S」フラッグシップ検査装置に先立ち、次世代検査装置開発のバージョン 1 として、「WTS-577SX」のリリースを同じく当第 4 四半期を目途に計画しております。「WTS-577SX」に関して、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を現在継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代 LCD ドライバ IC 検査装置 WTS-577SR と共用の上、更に使い勝手の向上に向けて新 GUI(注 1)を装備し、コスト削減と市場への早期リリースができるように計画しております。

(注1：Graphical User Interface の略で、コンピューターの画面上に表示されるウィンドウやアイコン、ボタンなど、人間が操作するための画面インターフェース)

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用し、且つ当社、ウインテスト武漢の技術陣に加え、現地有力企業より営業方面・技術方面での協力体制を構築することで、2025年までに、今後市場拡大が見込まれるシステムオンチップ(SoC) (注1) 市場や汎用デジタル市場等の検査分野、そしてM&Aも計画し、日本市場においても注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、資本提携や協力体制を積極的に進め、新規市場参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を行い、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

(注1：一枚の基板(チップ)上に半導体など各種素子を実装し、一つの統合されたシステムを組み込んでいる半導体集積回路のこと)

### ⑤財務施策

財務面については、2023年1月13日開催の取締役会において、GFA株式会社を割当先とする第三者割当による新株予約権の発行を決議し、2023年1月30日にその引受代金の払込も完了し、その行使により開示した資金使途への充当をしております。なお、途中で見直しが発生した一部資金使途に関し、2023年8月4日に変更の開示、また2023年9月11日に「(再訂正)資金使途の変更に関するお知らせ」の一部再訂正を開示しております。また今後も、事業拡張を考えた財務戦略として、筆頭株主である武漢精測電子集团股份有限公司(以下、「武漢精測」といいます。)と諮りながら、武漢精測グループ及び投資機関からの資本増強あるいは同グループからの借入を計画し、資金確保についての施策を今後とも継続実施してまいります。

### (2) 資金調達目的及び理由

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でおりますが、アフターコロナ、テレワーク需要の減少などの影響で半導体市場は、在庫の積み上がりを嫌い、生産調整から設備投資の大幅な減退を受けて大きく低迷しております。当社がメイン市場とする海外の新規受注並びに受注済み検査装置の出荷、売上は、中国経済が上向くと見込まれる当年度半ば以降と想定しております。事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、資金の調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。従いまして、当社の状況として、上述のとおり、依然として安定した収益基盤が構築されているとは言えないことから、当社としても強固な収益基盤の確立が急務であると認識しております。そのため、短期的に収益基盤の確立を行うためには、既存事業の経営効率の改善に加え、次世代検査装置の開発を完了し収益の柱とすること、またSoCなど複合IC検査装置及びパワー半導体市場への参入、それに伴う技術者の採用等、事業規模の拡大を行うことが急務であると判断しました。そのため、事業の基盤形成を行うべく後述する資金使途における事業資金の確保のため、本第三者割当による資金調達を行うことといたしました。

今回の本第三者割当による新株式の発行を実施、新たな資金調達によって当社グループの事業拡大につながる施策を実行することで、企業価値及び株式価値の向上が図れると判断しております。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額

払込金額の総額 (円)	発行諸費用の概算額 (円)	差引手取概算額 (円)
-------------	---------------	-------------

399,921,000	7,550,000	392,371,000
-------------	-----------	-------------

- (注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。  
 2. 発行に係る諸費用 7,550,000 円の内訳は、登記費用・司法書士手数料約 2,800,000 円、引受契約書等作成支援費用 1,500,000 円、有価証券届出書作成費用 3,000,000 円、割当予定先調査費 250,000 円を見込んでおります。  
 3. 調達資金を実際に支出するまでは、当社預金口座で適切に管理する予定であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
①次世代先端システム (WTS-9000S) 開発資金 及びバリエーション展開費用	70	2023年10月～2024年8月
② 技術者増強に伴う人件費等(技術営業、開発技術者、アプリ、サポート開発人員)	100	2023年10月～2024年12月
③SoC 向け検査装置市場への参入のための準備費用	150	2023年12月～2024年12月
④その他運転資金	72	2023年10月～2024年4月
計	392	

本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途は以下の通りです。

①次世代先端システム (WTS-9000S) 開発資金及びバリエーション展開費用

当社が推進する次世代検査装置開発プロジェクトにおいては、国内最大手競合メーカーが展開する検査装置に匹敵する次世代装置の開発を継続しております。現在当社は、開発レベルをバージョン1とバージョン2に分け、先ず2023年8月までにバージョン1となるI/O高速デジタルパターン発生器と超高速ドライバー、高精度デジタイザ等の開発を完了し、WTS-577SXとして2023年10月1日より販売を開始いたします。

今後も引続きバージョン2となるWTS-9000Sの開発を継続しており、当社の業績向上と継続的な会社成長に重要となる、次世代フラッグシップ検査装置 (WTS-9000S) の新規開発及びバリエーション展開を行う予定です。

そのため、当社の次世代検査装置の新規開発及びバリエーション展開費用のため、本第三者割当にて調達した資金のうち、70百万円を充当する予定です。

②技術者増強に伴う人件費(技術営業、開発技術者、アプリ、サポート開発人員)

当社は新技術の研究開発とお客様毎のカスタマイズのできるアプリケーションエンジニア、またサポート力の向上を目的に、新たなエキスパート人材の採用が不可欠であり、新しい人材を登用した組織改革を行う事で、日々進化する半導体に即した検査技術をお客様に提供し、常に全力で走ることが必要となります。

しかし、半導体及び電子系技術者の人材不足は深刻さを増しており、人件費の高騰が懸念されている状況です。当社はこのような状況に対応すべく、開発技術者 (ハード、ソフト) で若干名、アプリ、サポート開発で同じく若干名の増員を予定しております。

そのため、本第三者割当にて調達した資金のうち、新規採用 (リクルート) 費用他、増加人件費等を勘案し100百万円程度を充当する予定です。

③SoC 向け検査装置市場への参入のための準備費用

今後、半導体産業は、トヨタが提唱し、2024年にも開始されるとする、実験都市

「ウーブン・シティ」（静岡）、そこではロボットや AI 技術を駆使した都市型 DX と  
いわれる「スーパーシティ」、また内閣府構想「まるごと未来都市」のような取り  
組みも始まり、今後は、飛躍的な量の半導体が必要とされる世界となってまいります。  
その中で重要な役割を果たす人間とデジタルのインターフェースであるディスプレイ  
を駆動する DDIC（液晶ディスプレイや有機 EL ディスプレイなどの画面を制御するた  
めの集積回路）及び、より複雑化する半導体集積回路（IC）への機能要求に応える  
SoC（注1）構造を持つ半導体が爆発的に増えることを想定し、先端市場へのビジネ  
ス展開を目指し、SoC 向け検査装置事業へ参入を計画します。

そのため、本第三者割当にて調達した資金のうち、SoC 向け検査装置市場への参入  
のための準備費用として 150 百万円程度を充当する予定です。（協力会社からのベー  
ス装置購入費用 50 百万円、社内開発陣による SoC 装置化 50 百万円、周辺装置他 50 百  
万円）

注1：「System on a Chip」（システム・オン・ア・チップ）の略であり、単一の集  
積回路（チップ）上に、複数の異なる機能やコンポーネントを統合した電子デバイス。  
コンピュータや電子機器をより小型化し、高度に統合された設計を可能にする技術。

#### ④その他運転資金

当社の出入金のサイクルとして顧客からの売上入金、主な顧客が中国からという  
地域の慣習上 6 か月、一部は 12 か月となることが多く、その間の運転資金に不足が生  
じる可能性があり、安定的な資金繰り向け、本第三者割当にて調達した資金のうち、  
社内計測機器、製造に使用する機器のメンテナンスや新規増設などへ一部充当、また  
本社及び大阪事業所などの付帯設備等のメンテナンス他をその他運転資金として 72 百  
万円程度の充当をする予定です。

#### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3. 調達する資金の額、使途及び  
支出予定時期（2）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、当  
社の成長戦略を実行し企業価値の向上を実現することは、既存株主の利益にもつながる  
ため、当該資金の使途は一定の合理性を有していると判断しております。

#### 5. 発行条件等の合理性

##### (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

本新株式における発行価額は、割当予定先との協議の結果、本新株式に係る取締役会  
決議日の直前取引日（2023 年 9 月 14 日）の株式会社東京証券取引所スタンダード市場に  
おける当社株式の終値 115 円を基準とし、直前取引日の終値である 115 円から 5.22%デ  
ィスカウントした 109 円といたしました。

上記発行価額は、直近の市場価額に基づくものが合理的であると判断したこと及び、  
日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（2010 年 4 月 1 日付 以下、  
「日証協指針」といいます。）によると、第三者割当により株式の発行を行う場合には、  
その払込金額は原則として株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日にお  
ける売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日の価額）を基準として決定するこ  
ととされているため、本件第三者割当の発行価額を決定する際にも、本件第三者割当に  
係る取締役会決議の直前営業日の終値を基準といたしました。

また、発行価額のディスカウント率を 5.22%とした経緯としましては、当社が 2022 年  
8 月に継続企業の前提に関する事項の注記が付されていること、過去事業年度において  
経常損失を計上していることを勘案し、割当予定先からの発行価額における 5%程度の  
ディスカウントの打診を受け、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指  
針」に準拠する 10%を超えない範囲で、相応の率をディスカウントすることはやむを得  
ないと判断し、発行価額について割当予定先のディスカウントに対する要望を受け入れ

た結果によるものとなります。

なお、当該発行価額は、本件第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前取引日の終値である 115 円から 5.22%のディスカウント、当該直前取引日までの1カ月間の終値平均である 107.35 円から 1.54%のプレミアム、当該直前取引日までの3カ月間の終値平均である 114.22 円から 4.57%のディスカウント、当該直近取引日までの6か月間の終値平均である 116.51 円から 6.44%のディスカウントとなっております。

以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達目的、他の調達手段の選択肢を考慮するとともに、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。なお、ディスカウント率についても日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に基づいても有利発行に当たらない範囲であるため合理的かつ適法であると当社取締役会において判断しております。

また、当社監査等委員3名(うち2名が社外監査等委員)も、本新株式の発行価額の算定方法については、取締役会決議日の直前取引日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合理的なものであり、また、5.22%のディスカウント率についても、本第三者割当による増資規模の必要性、本第三者割当で発行する当社株式の流通量が既存株主に与える影響(詳細は、下記「(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方」を参照)、当社の業績及び信用リスク、割当予定先が負う価格下落リスクの諸観点から当該ディスカウント率の合理性について十分な検討が行われていること及び日証協指針も勘案されていることから、有利発行でないことについて異論がない旨の意見が述べられております。

## (2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本第三者割当増資により増加する新株式数 3,669,000 株は、現在の発行済株式総数 39,972,000 株に対し 9.18% (2023年6月30日現在の当社総議決権数 399,662 個に対しては 9.18%) の割合で希薄化が生じます。

しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当増資により得られる調達資金により事業拡大に向けた戦略的な取り組みを図り将来的には財務体質の改善・強化が可能となります。そのことにより、企業価値及び株式価値の向上を図ることで、既存株主にとっても合理的であると判断しております。

## 6. 割当予定先の選定理由等

### (1) 割当予定先の概要

#### ①楽言海外国際(香港)有限公司

① 名 称	楽言海外国際(香港)有限公司
② 所 在 地	香港金鐘金鐘道 89 號力寶中心第一座 10 楼 1003 室
③ 代表者の役職・氏名	Director 胡 海勇
④ 事 業 内 容	中国、韓国、日本における半導体検査装置関連製品の輸出入及び販売
⑤ 資 本 金	359 百万円 (2023 年 7 月 31 日現在) (注) 1
⑥ 設 立 年 月 日	2018 年 9 月 20 日
⑦ 発 行 済 株 式 数	20,000,000 株
⑧ 決 算 期	12 月末
⑨ 従 業 員 数	5 名
⑩ 主 要 取 引 先	SMC 株式会社、三菱ケミカル株式会社、中芯国際集成電路製有限公司 (SMIC)、京东方科技集团股份有限公司 (BOE)、惠科股份有限公司 (HKC)、中航光電科技股分有限公司 (JONHON)、维信诺科技股份有限公司 (Visionox)、深圳華

	星光電技術有限公司 (CSOT)、杭州士兰微电子有限公司 (Silan)、武汉新芯集成电路制造有限公司 (XMC)		
⑪ 主要取引銀行	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited		
⑫ 大株主及び持株比率	胡海勇	45.0%	
	郁伟	25.0%	
	郑建中	15.0%	
	胡毅	15.0%	
⑬ 当事会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	該当事項はありません。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位円)			
決算期	2020年12月期 (注) 2	2021年12月期 (注) 3	2022年12月期 (注) 4
純資産	180,255,463	214,871,632	391,690,995
総資産	260,710,280	237,794,468	497,620,180
1株当たり純資産	9	11	20
純収益	324,886,856	82,425,468	374,220,849
営業利益	115,089,055	16,140,724	111,924,516
当期純利益	115,089,055	16,140,724	111,924,516
1株当たり当期純利益	6	1	6
1株当たり配当金	-	-	-

注1：上記円換算は、2023年7月末の為替レート1円=140.97 USドルにて換算しております。

注2：上記円換算は、2020年12月末の為替レート1円=13.35香港ドルにて換算しております。

注3：上記円換算は、2021年12月末の為替レート1円=14.75香港ドルにて換算しております。

注4：上記円換算は、2022年12月末の為替レート1円=132.7USドルにて換算しております。

## (2) 割当予定先を選定した理由

当社は、当社が必要とする事業資金について、資金調達方法を検討しておりました。上述の財務施策のとおり、当社が必要とする事業資金について当社の大株主である武漢精測電子集团股份有限公司に相談したところ同社子会社になる上海精測有限公司（中華人民共和国 上海市 青浦区）の総経理である馬駿氏より、同氏が同じく総経理を務める同社のグループ会社である上海精積微半導体有限公司（以下、「上海精積微」といいます。）を2023年5月上旬に紹介いただきました。上海精積微は当社と同じく半導体の検査装置事業を行っており、営業や開発の一部においてはお互いに協力も出来る可能性もあることから、2023年5月下旬に当社代表取締役である姜輝が上海精積微を訪問、当社の資金需要を相談したところ、資金支援は応じられないものの、上海精積微社より同社の取引先である樂言海外國際(香港)有限公司（以下、「樂言」といいます。）をご紹介いただき、2023年5月下旬に当社代表取締役である姜輝より、樂言の会長である胡海勇氏へ資金需要を相談したところ、当社の資金需要及び事業戦略に賛同いただいたこと

から、楽言は2023年8月4日付で意向表明書をいただき、本第三者割当の引受けに至りました。

(3) 割当予定先の保有方針

当社は、割当予定先から、本第三者割当により取得する株式について純投資を目的としており、本第三者割当により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、市場動向を勘案しながら売却する方針と伺っております。

また、当社は、割当予定先から、払込期日から2年間において、割当予定先が本第三者割当により取得した当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由並びに譲渡の方法等の内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に書面により報告すること、当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することについて、割当予定先から払込期日までに確約書を取得する予定であります。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、割当予定先から、本株式の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を受けており、また、本第三者割当の資金は自己資金である手元現預金で賄うとのことでありました。当社としても、2023年8月19日付預金口座の異動明細表及び2023年8月7日付信用証明書にて直近の財務状況を再度確認していることから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

(5) 割当予定先の実態

当社は、割当予定先について、割当予定先の役員又は主要株主が暴力団等の反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティ&リサーチ（所在地：東京都港区赤坂二丁目8番11号 代表取締役：羽田寿次）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記のとおり割当予定先、割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないことを確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

7. 大株主及び持株比率

募集前(2023年6月30日現在)	持株比率
Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd. ( 常任代理人 三田証券株式会社 取締役社長 門倉 健仁 )	50.04%
大畑 雅稔	3.85%
楽天証券株式会社	3.65%
株式会社SBI証券	1.15%
FUBON SECURITIES CO., LTD. CLIENT 30 ( 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ダイレクト・カスタディ・クリアリング業務部長 石川 潤 )	0.98%
UBS AG HONG KONG ( 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ダイレクト・カスタディ・クリアリング業務部長 石川 潤 )	0.94%
いちよし証券株式会社	0.79%
松村 正人	0.39%
松井証券株式会社	0.37%

日本証券金融株式会社	0.35%
------------	-------

- (注) 1. 上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。  
 2. 募集前の大株主及び持株比率「持株比率」は、2023年6月30日時点の株主名簿を基準としております。  
 3. 割当予定先の保有目的は純投資とのことであり、割当予定先による当社普通株式の長期保有は約されておりませんので、割当後の「持株比率」の記載はしていません。

#### 8. 今後の見通し

今回の調達資金を、上記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2) 調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につながるものと考えております。また、今回の資金調達による、当期連結業績予想における影響はございません。

#### 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動が見込まれないことから、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」第432条に規定される独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

#### 10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

##### (1) 最近3年間の業績(連結)

	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期
売上高	805,047千円	307,576千円	210,315千円
営業利益	37,089千円	△730,710千円	△693,502千円
経常利益	50,667千円	△668,818千円	△683,764千円
親会社株主に帰属する当期純利益	31,703千円	△629,178千円	△686,241千円
1株当たり当期純利益(円)	0.96円	△19.04円	△19.87円
1株当たり配当金(円)	—	—	—
1株当たり純資産(円)	64.40円	47.86円	37.24円

##### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2023年6月21日時点)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	39,972,000株	100.0%
現時点での転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—
下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数	—	—

##### (3) 最近の株価の状況

###### ① 最近3年間の状況

	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期
始値	158円	280円	191円
高値	435円	347円	208円
安値	349円	175円	94円
終値	276円	189円	124円

② 最近 6 か月間の状況

	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月
始値	134 円	128 円	116 円	113 円	121 円	121 円
高値	151 円	132 円	123 円	125 円	130 円	124 円
安値	122 円	113 円	105 円	107 円	115 円	97 円
終値	126 円	115 円	114 円	121 円	121 円	108 円

③ 発行決議日前営業日における株価

	2023年9月14日
始値	116 円
高値	116 円
安値	114 円
終値	115 円

(4) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

第三者割当による第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 10 回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行

割当日	2022年2月16日
発行新株予約権数	35,310 個 本第 9 回新株予約権 30,310 個 本第 10 回新株予約権 5,000 個
発行価額	総額 3,625,650 円 (第9回新株予約権 1 個につき 115円、第10回新株予約権1個につき 28円)
発行時における 調達予定資金の額	700,709,650 円 (差引手取概算額 : 697,921,650 円) (内訳) 本第 9 回新株予約権 新株予約権発行による調達額 : 3,485,650 円 新株予約権行使による調達額 : 497,084,000 円 本第 10 回新株予約権 新株予約権発行による調達額 : 140,000 円 新株予約権行使による調達額 : 200,000,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
割当先	三田証券株式会社
募集時における 発行済株式数	33,041,000株
当該募集による 潜在株式数	3,531,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株) 本第 9 回新株予約権 3,031,000 株 本第 10 回新株予約権 500,000 株 本新株予約権の下限行使価額は 132 円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は 3,531,000 株です。

現時点における 行使状況	第9回新株予約権行使は完了しました。 第10回新株予約権については、全て取得・消却済み。
現時点における 調達した資金の額	第9回新株予約権行使完了による調達額 421,127,650 円 (418,339,650 円) 第10回新株予約権については、全て取得・消却済み 調達金額はありません。
発行時における当初の資金 使途及び支出予定時期	上記差引手取概算額については、 (i)製造部材調達及び外注製作費、407,921,650 円 (ii)技術者増強及び運転資金、90,000,000 円 に充当するものです。
現時点における 充当状況	2022年11月29日付(訂正)「第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第10回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の発行に関するお知らせ」の一部訂正について記載のとおり、調達した421,267,650円については、それぞれ、(i)に336,283,982円、(ii)技術者増強及び運転資金84,983,668円を充当しております。

#### 第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行

割当日	2023年1月30日
発行新株予約権数	3,900個
発行価額	総額 4,914,000 円 (第11回新株予約権1個につき126円)
発行時における 調達予定資金の額	500,214,000 円 (差引手取金概算額: 498,114,000 円) (内訳) 第11回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 4,914,000 円 新株予約権行使による調達額: 495,300,000 円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
割当先	GFA 株式会社
募集時における 発行済株式数	39,972,000株
当該募集による 潜在株式数	3,900,000 株 (新株予約権1個につき100株) 本新株予約権の下限行使価額は83円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は3,900,000株です。
現時点における 行使状況	第11回新株予約権行使は完了しました。
現時点における 調達した資金の額 (差引手取概算額)	第11回新株予約権行使完了による調達額 433,388,200 円 (430,088,200円)

<p>発行時における当初の資金使途及び支出予定時期</p>	<p>①装置製造に関わる半導体部材仕入れ等：130百万円 (2023年1月～2023年10月)</p> <p>②次世代先端システム開発費、バリエーション展開：100百万円 (2023年1月～2023年12月)</p> <p>③技術者増強(技術営業、開発、サポート)：100百万円 (2023年3月2024年12月)</p> <p>④製造工場移転増強：70百万円 (2024年3月～2025年12月)</p> <p>⑤その他運転資金：70百万円 (2023年1月～2024年12月)</p>
<p>現時点における 充当状況 (2023年8月31日現在)</p>	<p>現時点(2023年8月31日現在)までに調達した410,658,297円については、下記のとおり充当しております。</p> <p>① 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等:58百万円</p> <p>② 次世代先端システム研究開発費 バージョン1：19百万円</p> <p>③ 技術者増強(技術営業、開発、サポート)：69百万円</p> <p>④ 当社100%子会社(ウインテスト武漢)への一括貸付(運転資金、資材購入、拠点移転費用)：70百万円</p> <p>⑤ GFA株式会社への返済：47百万円</p> <p>⑥ その他当社運転資金：146百万円</p>

(別紙)

ウインテスト株式会社  
募集株式の発行要項

1	株式の種類及び数	普通株式 3,669,000 株
2	払込金額	1 株当たり金 109 円
3	払込金額の総額	金 399,921,000 円
4	払込期日	2023 年 10 月 2 日～2023 年 11 月 30 日
5	増加する資本金の額	金 199,960,500 円
6	増加する資本準備金の額	金 199,960,500 円
7	募集の方法	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。
8	割当先及び割当株式数	楽言海外国際(香港)有限公司 3,669,000 株
9	その他	但し、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とする。

以上